

2018年（平成30年）3月期 決算説明会

株式会社フジミインコーポレーテッド

2018年5月18日

1. 決算概要

【業績】

- ✓ 売上高 8.1%増収 : 半導体（シリコンウエハー、ロジック・メモリデバイス）好調
- ✓ 営業利益 13.9%増益 : 半導体好調、製品ミックスの良化
- ✓ CMP向け : 半導体好調により3期連続で過去最高売上を更新
- ✓ シリコンウエハー向け : 半導体好調により増収
- ✓ ハードディスク向け : 顧客統合によるプロセス変更に伴う使用量減等により減収
- ✓ 一般工業用向け : (研磨材) 最終製品の生産調整の影響を受け減収
(非研磨材)溶射材の半導体製造装置向け好調で増収

【投資】

- ✓ 台湾子会社 : 次世代（10nm/7nm）向け製造ライン拡張完了
(2016/3期～2018/3期 投資合計約10億円)
- ✓ CVCファンド : 投資開始
(3億円の内、4社、累計1億円の投資を実行)

業績概要 (通期実績)

単位：百万円	17年3月期	18年3月期							
	通期実績	期初予想 ('17/5)	修正予想 ('17/8)	修正予想 ('17/11)	修正予想 ('18/2)	通期実績	前年比	期初 ('17/5) 予想比	修正 ('18/2) 予想比
売上高	33,092	33,000	34,000	34,500	35,500	35,788	+8.1%	+8.4%	+0.8%
営業利益	4,278	3,800	4,100	4,400	4,800	4,872	+13.9%	+28.2%	+1.5%
営業利益率	12.9%	11.5%	12.1%	12.8%	13.5%	13.6%	-	-	-
経常利益	4,519	3,900	4,200	4,400	4,800	4,728	+4.6%	+21.2%	△1.5%
経常利益率	13.7%	11.8%	12.4%	12.8%	13.5%	13.2%	-	-	-
当期純利益	3,350	2,800	3,000	3,200	3,500	3,011	△10.1%	+7.5%	△14.0%

(前期比) 半導体市場好調により、増収増益

※当期純利益は減損損失 568百万円 (税引後530百万円) 計上により減益

業績概要 (半期実績)

単位：百万円	17年3月期		18年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	上期比
売上高	16,254	16,838	17,417	+7.2%	+3.4%	18,371	+9.1%	+5.5%
営業利益	2,100	2,178	2,289	+9.0%	+5.1%	2,583	+18.6%	+12.8%
営業利益率	12.9%	12.9%	13.1%	-	-	14.1%	-	-
経常利益	2,171	2,348	2,250	+3.6%	△4.2%	2,478	+5.5%	+10.2%
経常利益率	13.4%	13.9%	12.9%	-	-	13.5%	-	-
当期純利益	1,710	1,640	1,647	△3.7%	+0.4%	1,364	△16.8%	△17.2%

- ・18/3期の半導体市場が下期にかけて伸長したことに伴い、業績は下期が上期を上回る
- ・18/3期下期の減損損失の計上により、下期の当期純利益は前期比16.8%減

業績予想 (通期)

単位：百万円	17年3月期	18年3月期	19年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	33,092	35,788	36,500	+2.0%
営業利益	4,278	4,872	5,100	+4.7%
営業利益率	12.9%	13.6%	14.0%	-
経常利益	4,519	4,728	5,200	+10.0%
経常利益率	13.7%	13.2%	14.2%	-
当期純利益	3,350	3,011	3,900	+29.5%

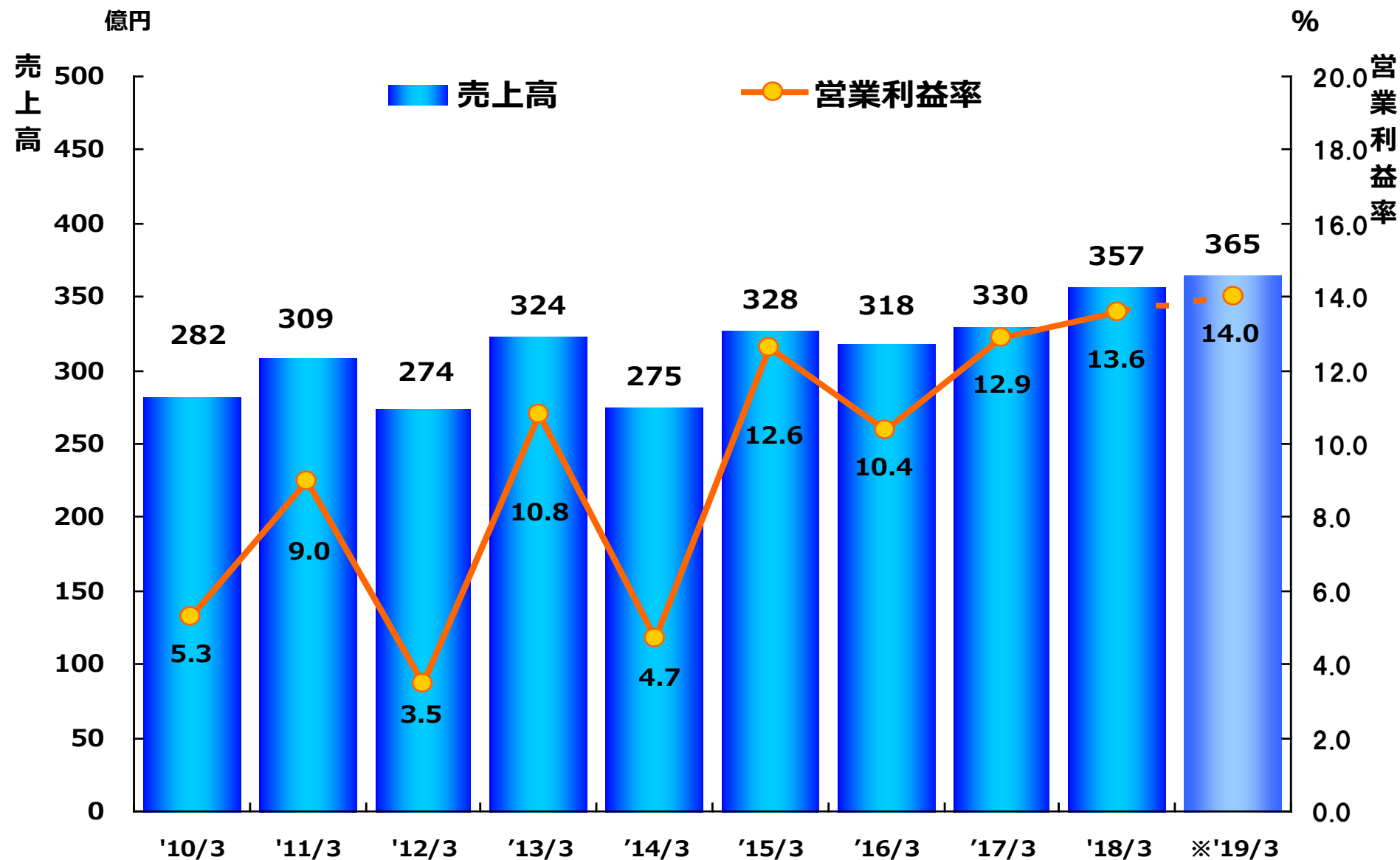
- ・為替レートを105円/ドルと想定するも（前期為替レート111円/ドル）、半導体市場好調により、19/3期は前年比で増収増益を見込む
- ・減損の影響がなくなるため、当期純利益は前期比29.5%増

業績予想 (半期)

単位：百万円	18年3月期		19年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	上期比
売上高	17,417	18,371	18,000	+3.3%	△2.0%	18,500	△1.2%	+0.8%
営業利益	2,289	2,583	2,550	+11.4%	△1.2%	2,550	△1.2%	+0.0%
営業利益率	13.1%	14.1%	14.2%	-	-	13.8%	-	-
経常利益	2,250	2,478	2,600	+15.5%	+4.9%	2,600	+4.9%	+0.0%
経常利益率	12.9%	13.5%	14.4%	-	-	14.1%	-	-
当期純利益	1,647	1,364	1,950	+18.4%	+43.0%	1,950	+43.0%	+0.0%

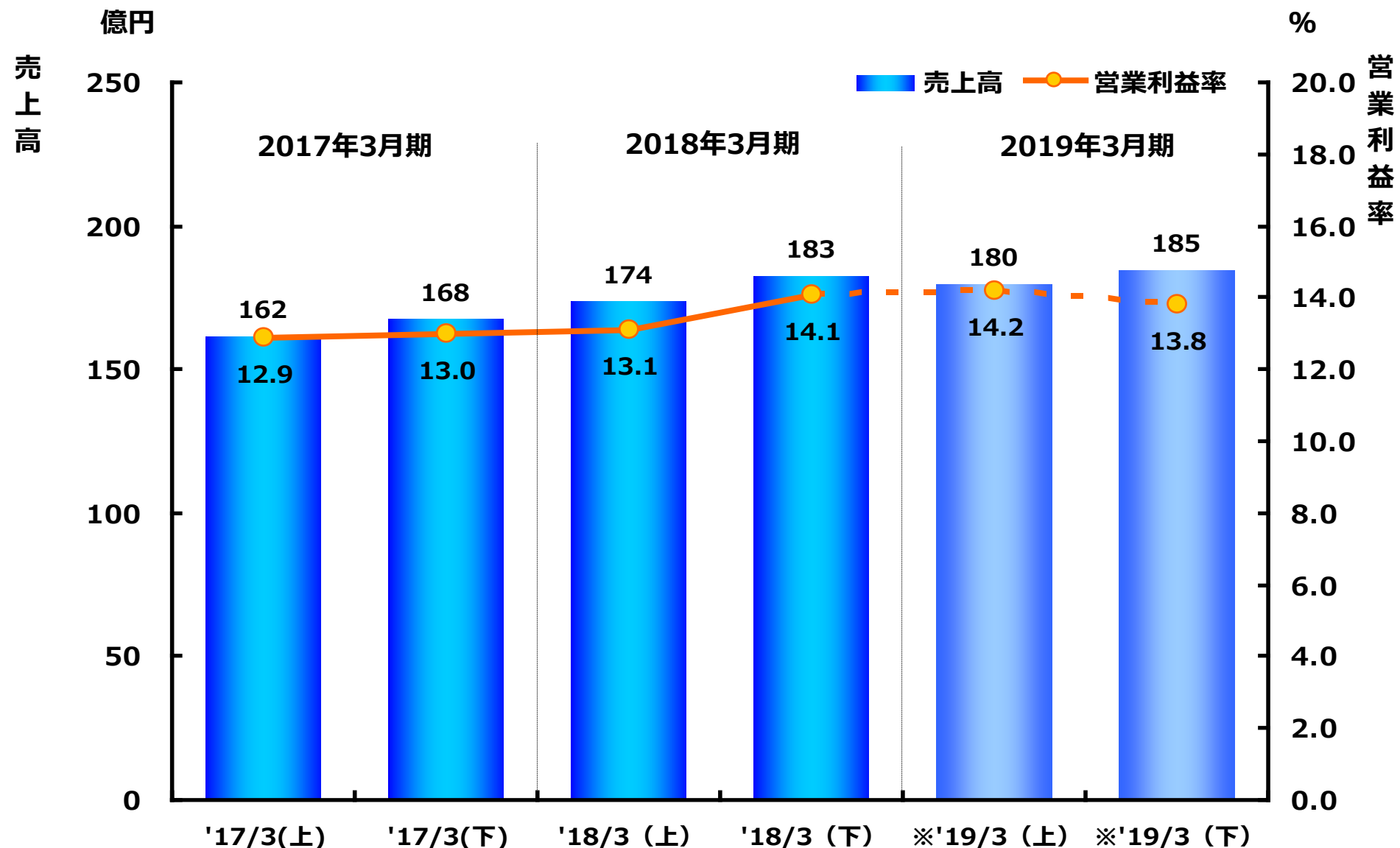
下期については、経費の増加を見込み、上期比で増収となるも利益は横這い

業績推移 (通期)



※'19/3は業績予想数値

業績推移 (半期)



※'19/3 (上) (下) は業績予想数値

2. 用途別売上高

用途別売上高 (通期実績)

単位：百万円		17年3月期	18年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	3,193	3,588	+12.4%
	ポリシング	6,245	7,472	+19.6%
	切断	655	535	△18.3%
	計	10,094	11,596	+14.9%
CMP		12,270	14,621	+19.2%
ディスク	アルミディスク	3,195	2,694	△15.7%
	ガラスディスク	454	542	+19.4%
	計	3,650	3,236	△11.3%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	5,150	4,244	△17.6%
	一般工業用(非研磨材)	1,738	1,904	+9.6%
	計	6,889	6,149	△10.7%
製品売上高		32,903	35,603	+8.2%
商品売上高		188	185	△1.9%
売上高 合計		33,092	35,788	+8.1%

用途別売上高 (半期実績)

単位：百万円		17年3月期		18年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハー	ラッピング	1,600	1,592	1,735	+8.4%	+9.0%	1,852	+16.3%	+6.7%
	ポリシング	3,088	3,157	3,392	+9.8%	+7.4%	4,080	+29.2%	+20.3%
	切断	306	348	274	△10.4%	△21.3%	260	△25.2%	△4.9%
	計	4,995	5,099	5,402	+8.1%	+5.9%	6,193	+21.5%	+14.6%
CMP		5,781	6,488	7,200	+24.5%	+11.0%	7,420	+14.4%	+3.1%
ディスク	アルミディスク	1,475	1,719	1,408	△4.6%	△18.1%	1,285	△25.2%	△8.7%
	ガラスディスク	200	253	311	+54.8%	+22.8%	231	△8.7%	△25.7%
	計	1,676	1,973	1,719	+2.5%	△12.9%	1,517	△23.1%	△11.8%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	2,852	2,298	2,116	△25.8%	△7.9%	2,128	△7.4%	+0.6%
	一般工業用(非研磨材)	848	889	890	+5.0%	+0.2%	1,013	+14.0%	+13.8%
	計	3,701	3,187	3,007	△18.7%	△5.7%	3,142	△1.4%	+4.5%
製品売上高		16,155	16,748	17,329	+7.3%	+3.5%	18,273	+9.1%	+5.4%
商品売上高		99	89	87	△11.5%	△1.6%	97	+8.8%	+10.6%
売上高 1合計		16,254	16,838	17,417	+7.2%	+3.4%	18,371	+9.1%	+5.5%

用途別売上高 (通期予想)

単位：百万円		17年3月期	18年3月期	19年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	3,193	3,588	3,770	+5.1%
	ポリシング	6,245	7,472	8,150	+9.1%
	切断	655	535	280	△47.7%
	計	10,094	11,596	12,200	+5.2%
CMP		12,270	14,621	15,000	+2.6%
ディスク	アルミディスク	3,195	2,694	2,140	△20.6%
	ガラスディスク	454	542	260	△52.0%
	計	3,650	3,236	2,400	△25.8%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	5,150	4,244	4,600	+8.4%
	一般工業用(非研磨材)	1,738	1,904	2,100	+10.3%
	計	6,889	6,149	6,700	+9.0%
製品売上高		32,903	35,603	36,300	+2.0%
商品売上高		188	185	200	+8.1%
売上高 合計		33,092	35,788	36,500	+2.0%

用途別売上高 (半期予想)

単位：百万円		18年3月期		19年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年前期比
シリコンウエハー	ラッピング	1,735	1,852	1,840	+6.1%	△0.6%	1,930	+4.2%	+4.9%
	ポリシング	3,392	4,080	4,070	+20.0%	△0.2%	4,080	+0.0%	+0.2%
	切断	274	260	150	△45.3%	△42.3%	130	△50.0%	△13.3%
	計	5,402	6,193	6,060	+12.2%	△2.1%	6,140	△0.9%	+1.3%
CMP		7,200	7,420	7,460	+3.6%	+0.5%	7,540	+1.6%	+1.1%
ディスク	アルミディスク	1,408	1,285	1,060	△24.7%	△17.5%	1,080	△16.0%	+1.9%
	ガラスディスク	311	231	120	△61.4%	△48.1%	140	△39.4%	+16.7%
	計	1,719	1,517	1,180	△31.4%	△22.2%	1,220	△19.6%	+3.4%
機能材／溶射材	一般工業用(研磨材)	2,116	2,128	2,230	+5.4%	+4.8%	2,370	+11.4%	+6.3%
	一般工業用(非研磨材)	890	1,013	970	+9.0%	△4.2%	1,130	+11.5%	+16.5%
	計	3,007	3,142	3,200	+6.4%	+1.8%	3,500	+11.4%	+9.4%
製品売上高		17,329	18,273	17,900	+3.3%	△2.0%	18,400	+0.7%	+2.8%
商品売上高		87	97	100	+14.9%	+3.1%	100	+3.1%	+0.0%
売上高 合計		17,417	18,371	18,000	+3.3%	△2.0%	18,500	+0.7%	+2.8%

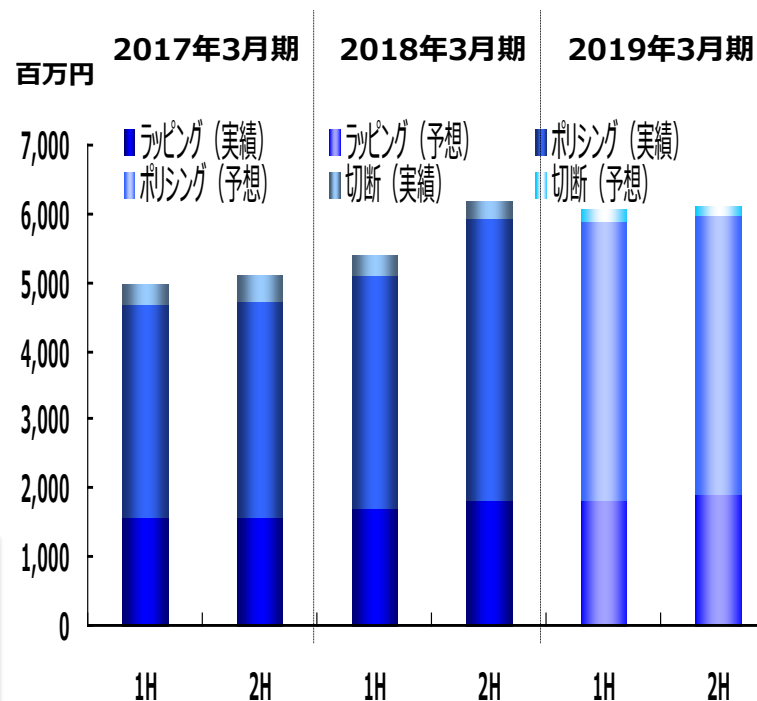
シリコンウエハー売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

<<通期>>

単位：百万円		17年3月期		18年3月期		19年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比	
シリコンウエハー	ラッピング	3,193	3,588	+12.4%	3,770	+5.1%	
	ポリシング	6,245	7,472	+19.6%	8,150	+9.1%	
	切断	655	535	△18.3%	280	△47.7%	
	計	10,094	11,596	+14.9%	12,200	+5.2%	

<<半期>>

単位：百万円		17年3月期		18年3月期		19年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコンウエハー	ラッピング	1,600	1,592	1,735	1,852	1,840	1,930
	ポリシング	3,088	3,157	3,392	4,080	4,070	4,080
	切断	306	348	274	260	150	130
	計	4,995	5,099	5,402	6,193	6,060	6,140



(18/3) 半導体好調とポリシング材の新規採用で増収
(19/3) 引き続き半導体好調による増収を予想

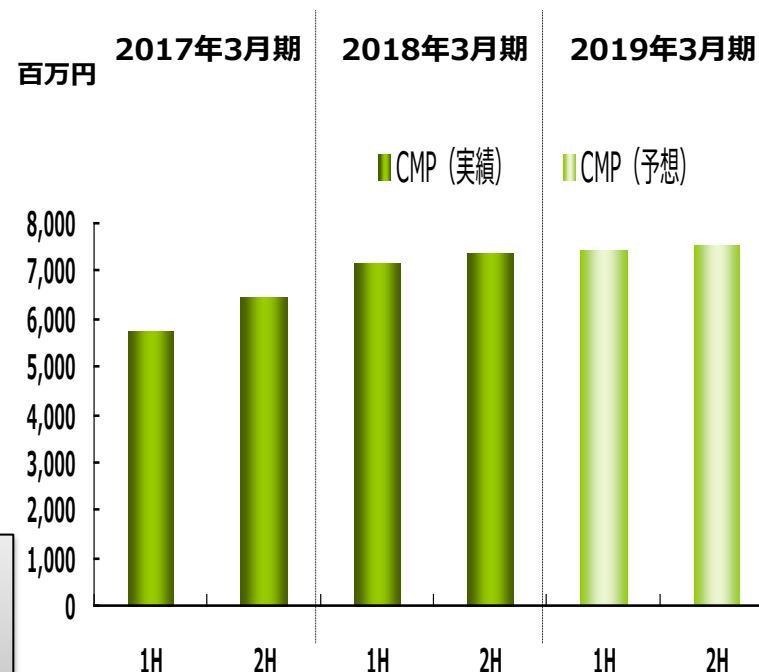
CMP売上高 (通期実績・予想、半期実績・予想)

<<通期>>

単位：百万円	17年3月期	18年3月期		19年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
CMP	12,270	14,621	+19.2%	15,000	+2.6%

<<半期>>

単位：百万円	17年3月期		18年3月期		19年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	5,781	6,488	7,200	7,420	7,460	7,540



(18/3) 最先端ロジック・メモリデバイス向け製品が好調で増収
(19/3) 円高による減収あるも引き続き最先端ロジック・メモリデバイス向け製品の好調を見込み増収を予想

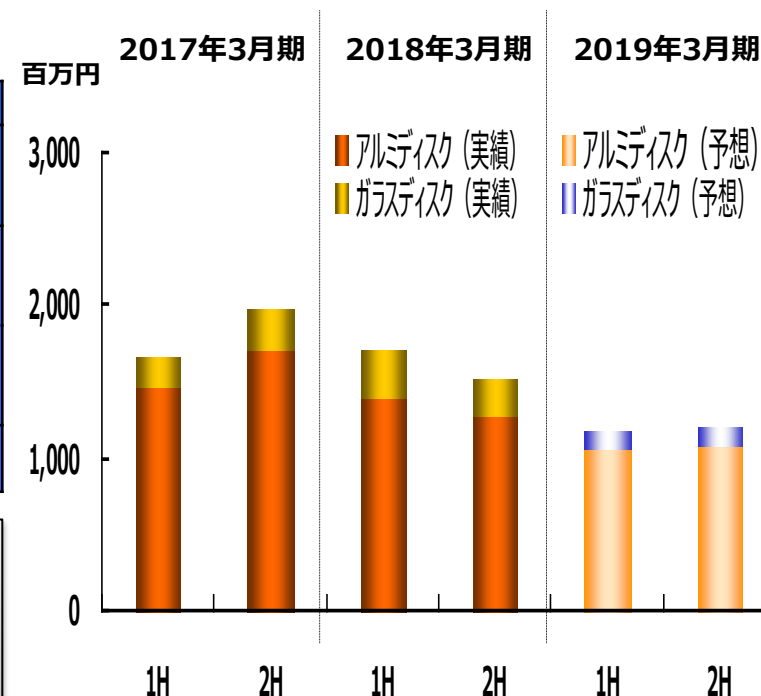
ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

<<通期>>

単位：百万円		17年3月期		18年3月期		19年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比	
ディスク	アルミディスク	3,195	2,694	△15.7%	2,140	△20.6%	
	ガラスディスク	454	542	+19.4%	260	△52.0%	
	計	3,650	3,236	△11.3%	2,400	△25.8%	

<<半期>>

単位：百万円		17年3月期		18年3月期		19年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	1,475	1,719	1,408	1,285	1,060	1,080
	ガラスディスク	200	253	311	231	120	140
	計	1,676	1,973	1,719	1,517	1,180	1,220



(18/3) 顧客統合によるプロセス変更・一部顧客の生産調整により減収

(19/3) シェア奪回が決まっておらず減収を予想

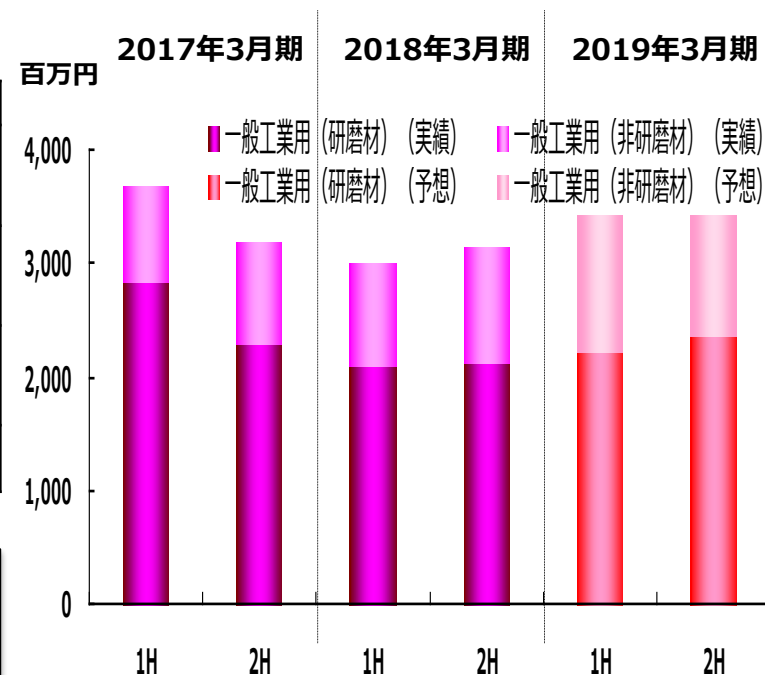
機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

<<通期>>

単位：百万円		17年3月期		18年3月期		19年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比	
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	5,150	4,244	△17.6%	4,600	+8.4%	
	一般工業用（非研磨材）	1,738	1,904	+9.6%	2,100	+10.3%	
	計	6,889	6,149	△10.7%	6,700	+9.0%	

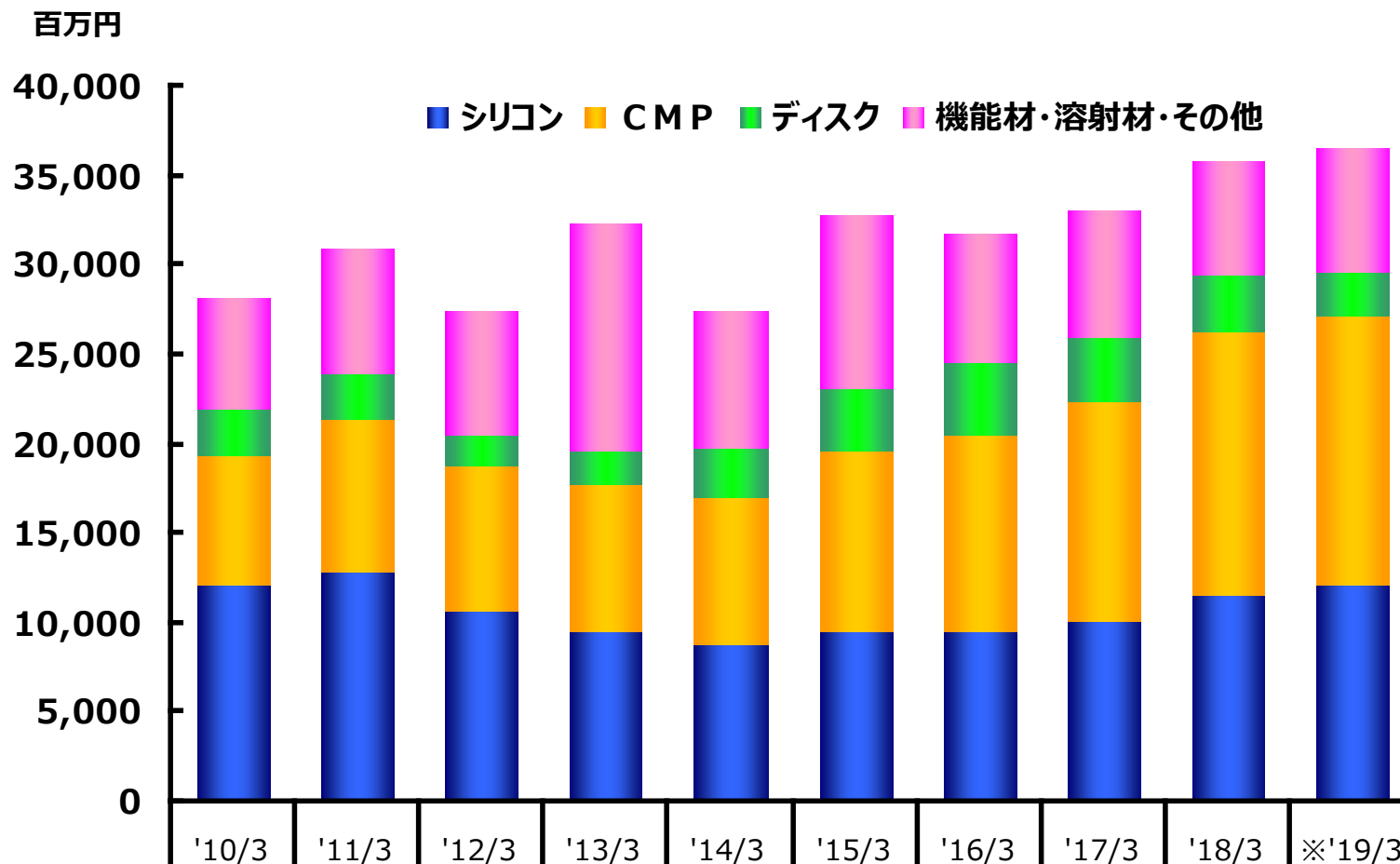
<<半期>>

単位：百万円		17年3月期		18年3月期		19年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	2,852	2,298	2,116	2,128	2,230	2,370
	一般工業用（非研磨材）	848	889	890	1,013	970	1,130
	計	3,701	3,187	3,007	3,142	3,200	3,500



【研磨材】（18/3）最終製品の製造プロセス変更により減収
（19/3）LED用サファイア基板、プラスチック向け等で増収を予想
【〃以外】（18/3）半導体・液晶ディスプレイ製造装置向け好調により増収
（19/3）引き続き半導体製造装置向け好調により増収を予想

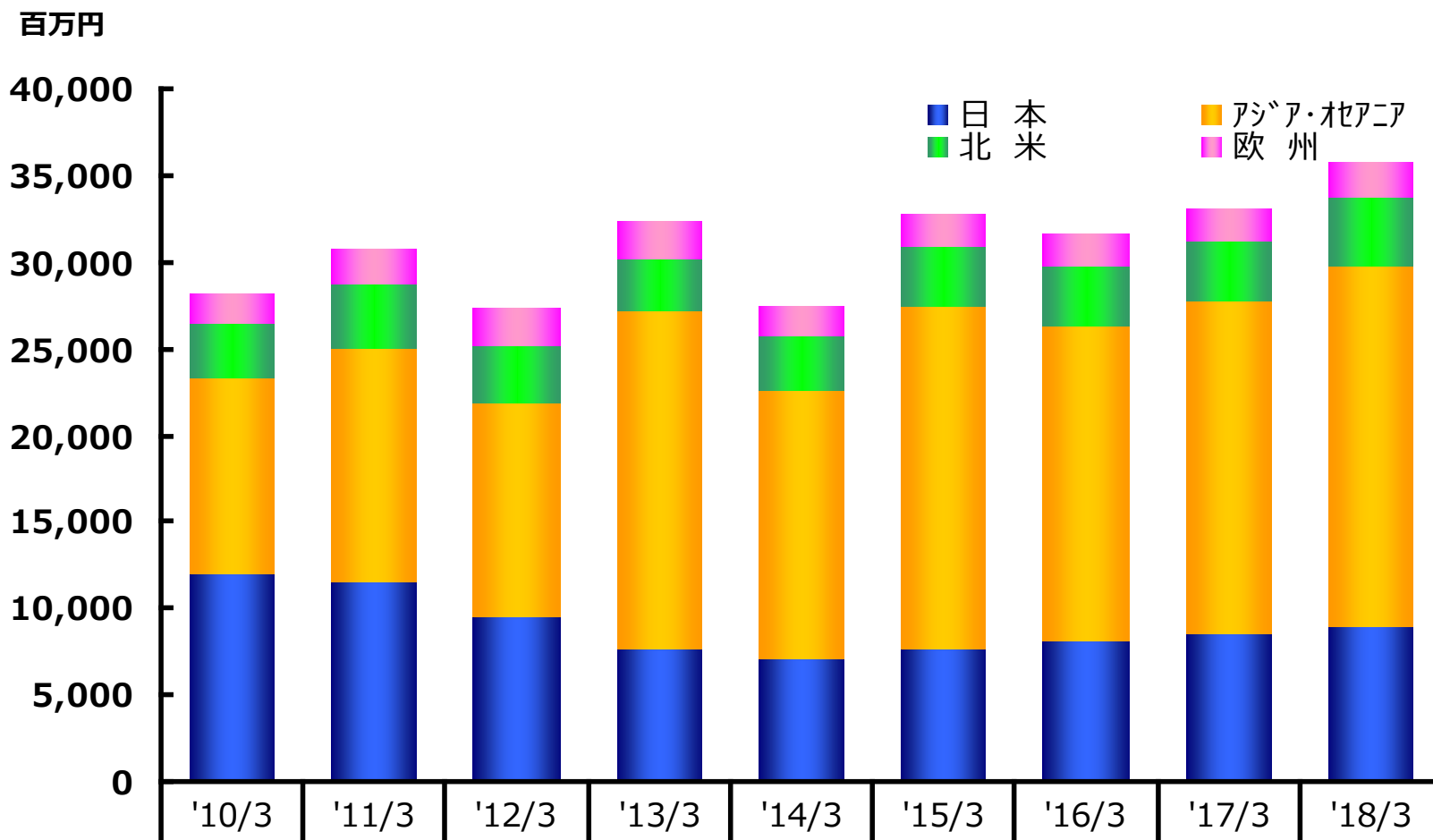
用途別売上高 (通期)



機能材・溶射材・その他	6,257	6,854	6,915	12,776	7,742	9,640	7,235	7,077	6,335	6,900
ディスク	2,570	2,689	1,788	1,826	2,658	3,478	4,041	3,650	3,236	2,400
CMP	7,262	8,532	8,029	8,323	8,224	10,143	10,980	12,270	14,621	15,000
シリコン	12,088	12,794	10,690	9,484	8,868	9,552	9,498	10,094	11,596	12,200

※'19/3 は業績予想数値

地域別売上高 (通期)

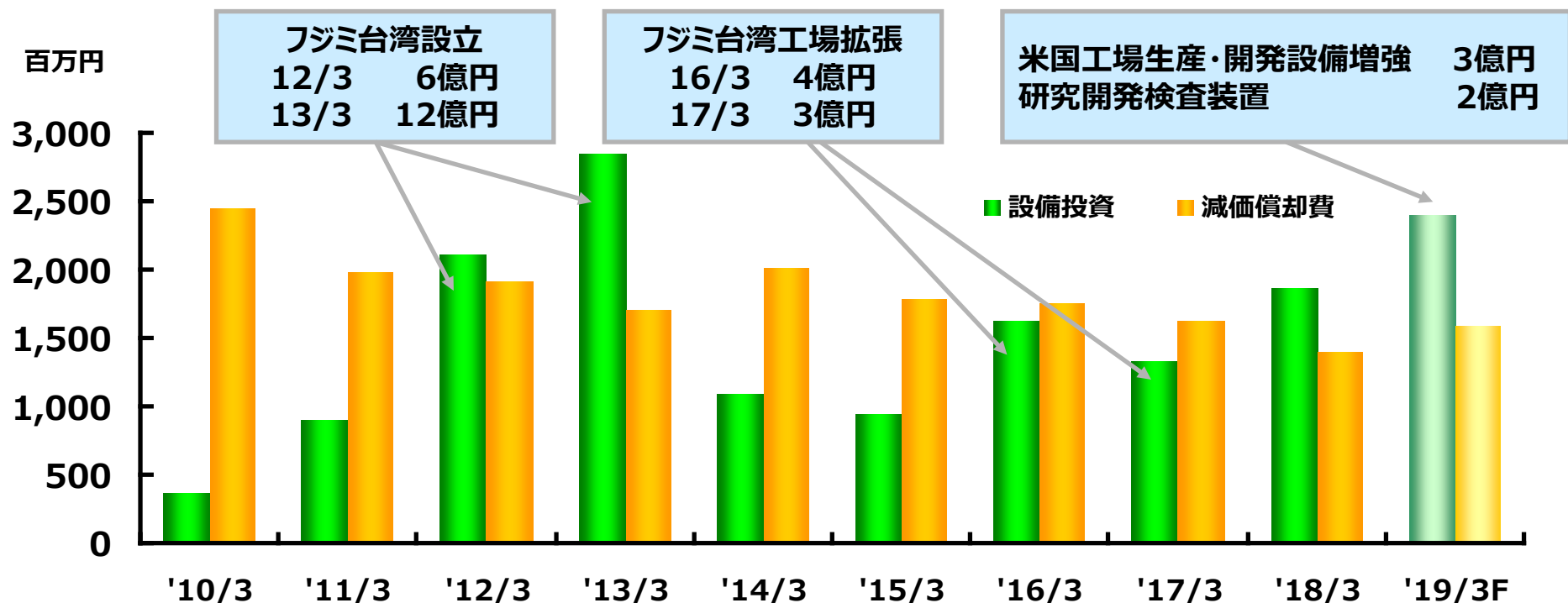


■ 欧州	1,718	1,990	2,183	2,127	1,718	1,849	1,989	1,815	2,000
■ 北米	3,126	3,829	3,282	3,046	3,075	3,500	3,431	3,507	3,907
■ アジア・オセアニア	11,256	13,469	12,389	19,542	15,490	19,668	18,228	19,186	20,862
■ 日本	12,076	11,579	9,568	7,696	7,208	7,799	8,106	8,584	9,019

3. 設備投資・減価償却費・研究開発費

設備投資・減価償却費（通期実績・通期計画）

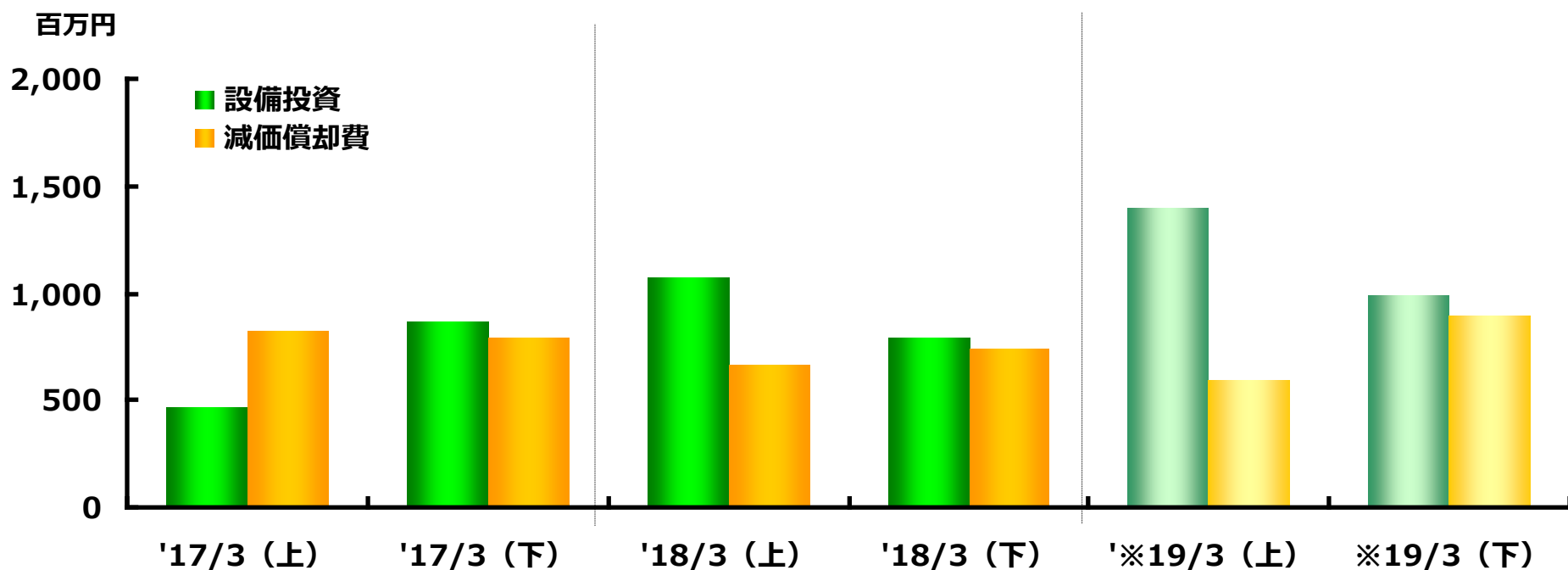
単位：百万円	17年3月期	18年3月期			19年3月期		
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比	通期計画	前年比
設備投資	1,336	2,000	1,879	+40.6%	△6.1%	2,400	+27.7%
減価償却費	1,623	1,500	1,411	△13.0%	△5.9%	1,600	+13.4%



※'19/3は業績予想数値

設備投資・減価償却費（半期実績・半期計画）

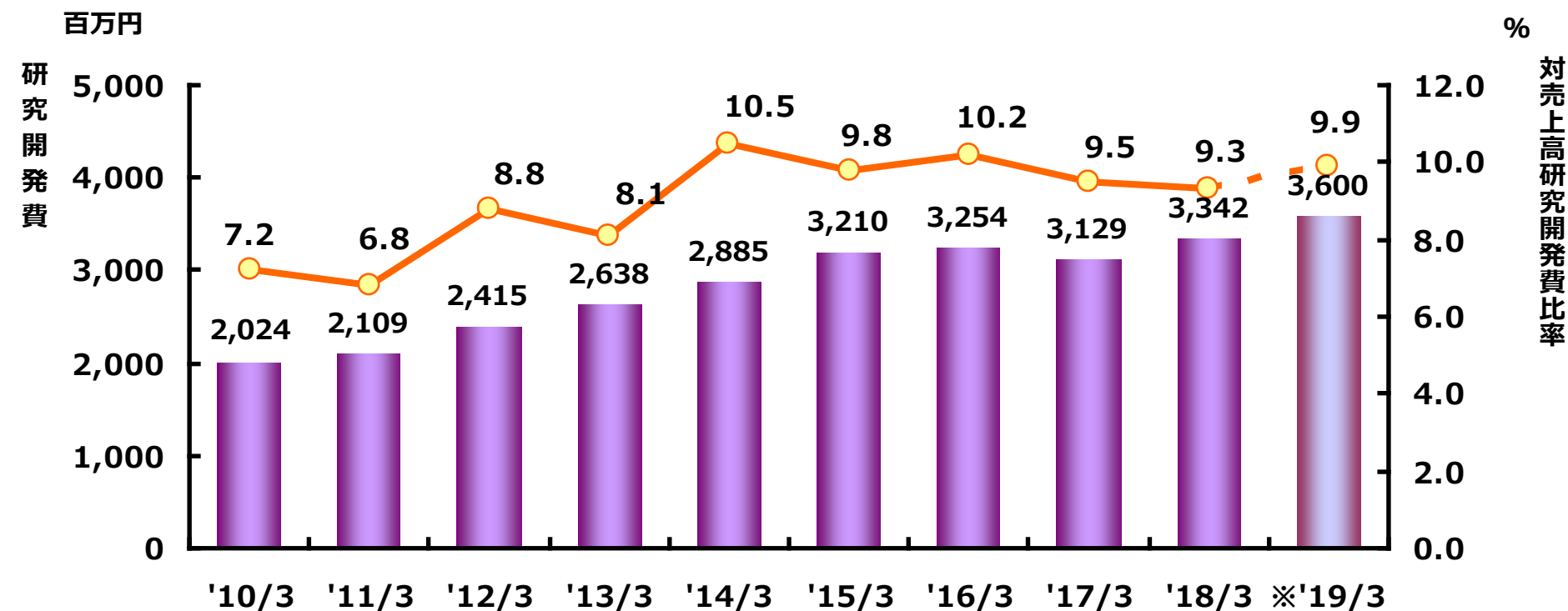
単位：百万円	17年3月期		18年3月期				19期3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績			上期計画			下期計画		
					前年同期比	上期比		前年同期比	前年下期比		前年同期比	上期比
設備投資	469	867	1,083	796	△8.2%	△26.5%	1,400	+29.3%	+75.9%	1,000	+25.6%	△28.6%
減価償却費	826	797	665	746	△6.4%	+12.2%	700	+5.2%	△6.2%	900	+20.6%	+28.6%



※'19/3 (上) (下) は業績予想数値

研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

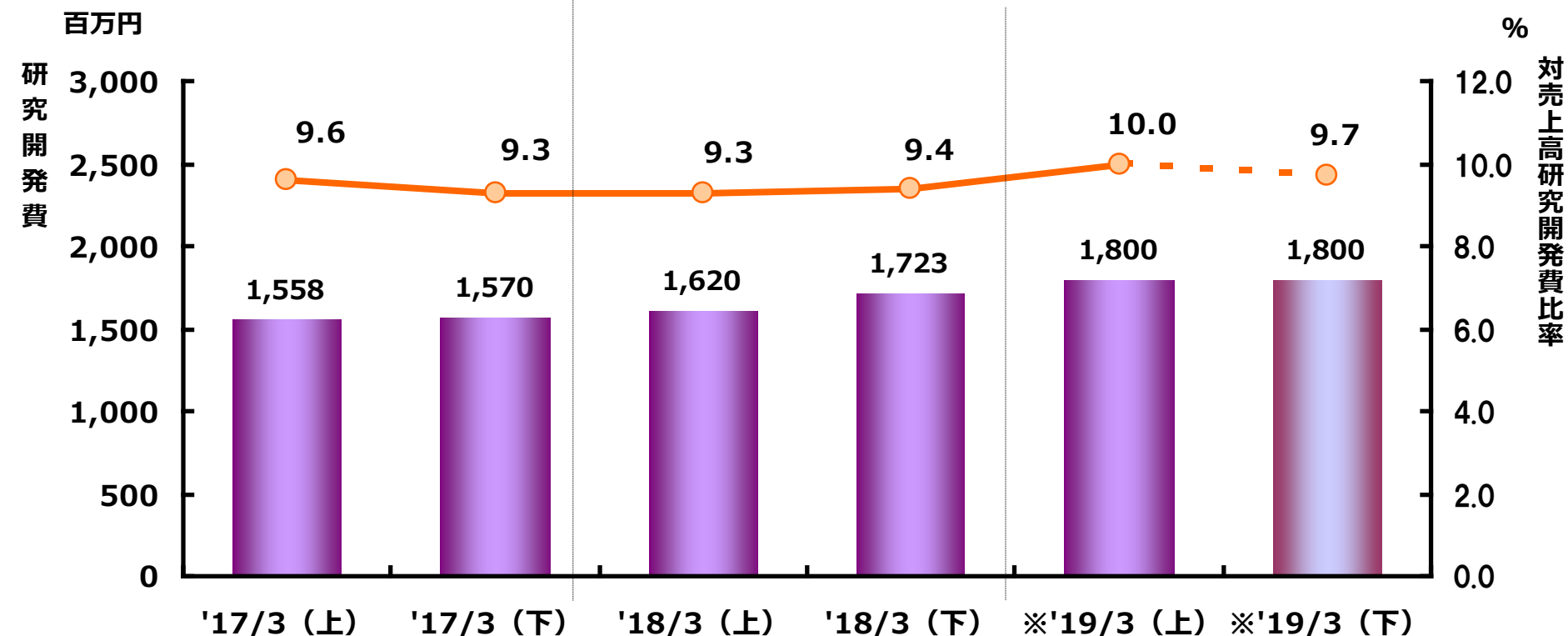
単位：百万円	17年3月期	18年3月期			19年3月期		
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比	通期計画	前年比
研究開発費	3,129	3,400	3,342	+6.8%	△1.7%	3,600	+7.7%



※'19/3は業績予想数値

研究開発費／売上高比（半期実績・半期計画）

単位：百万円	17年3月期		18年3月期				19年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	上期比
研究開発費	1,558	1,570	1,619	1,723	+9.8%	+6.4%	1,800	+11.1%	+4.5%	1,800	+4.5%	△0.0%

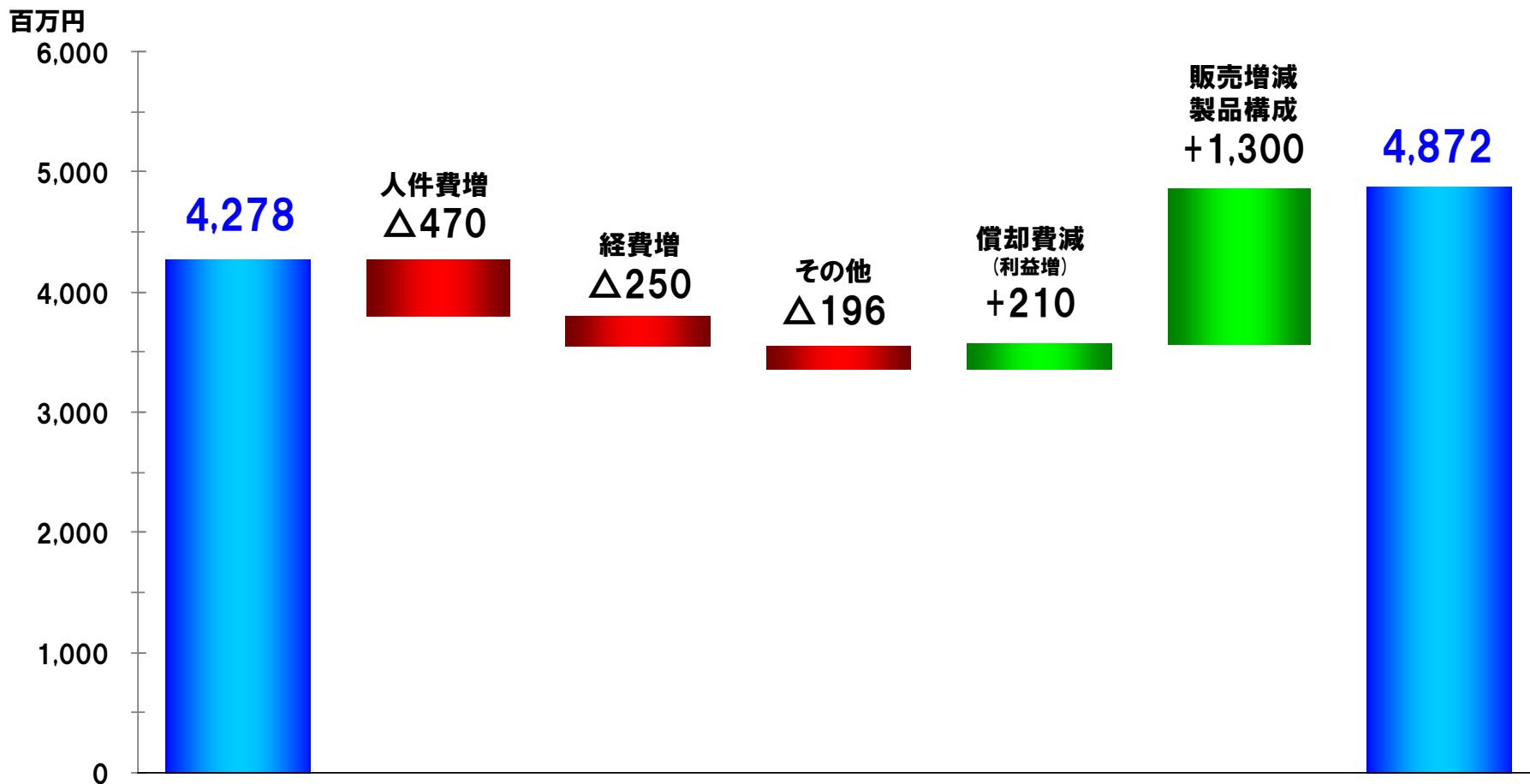


※'19/3 (上) (下) は業績予想数値

4. 損益分析

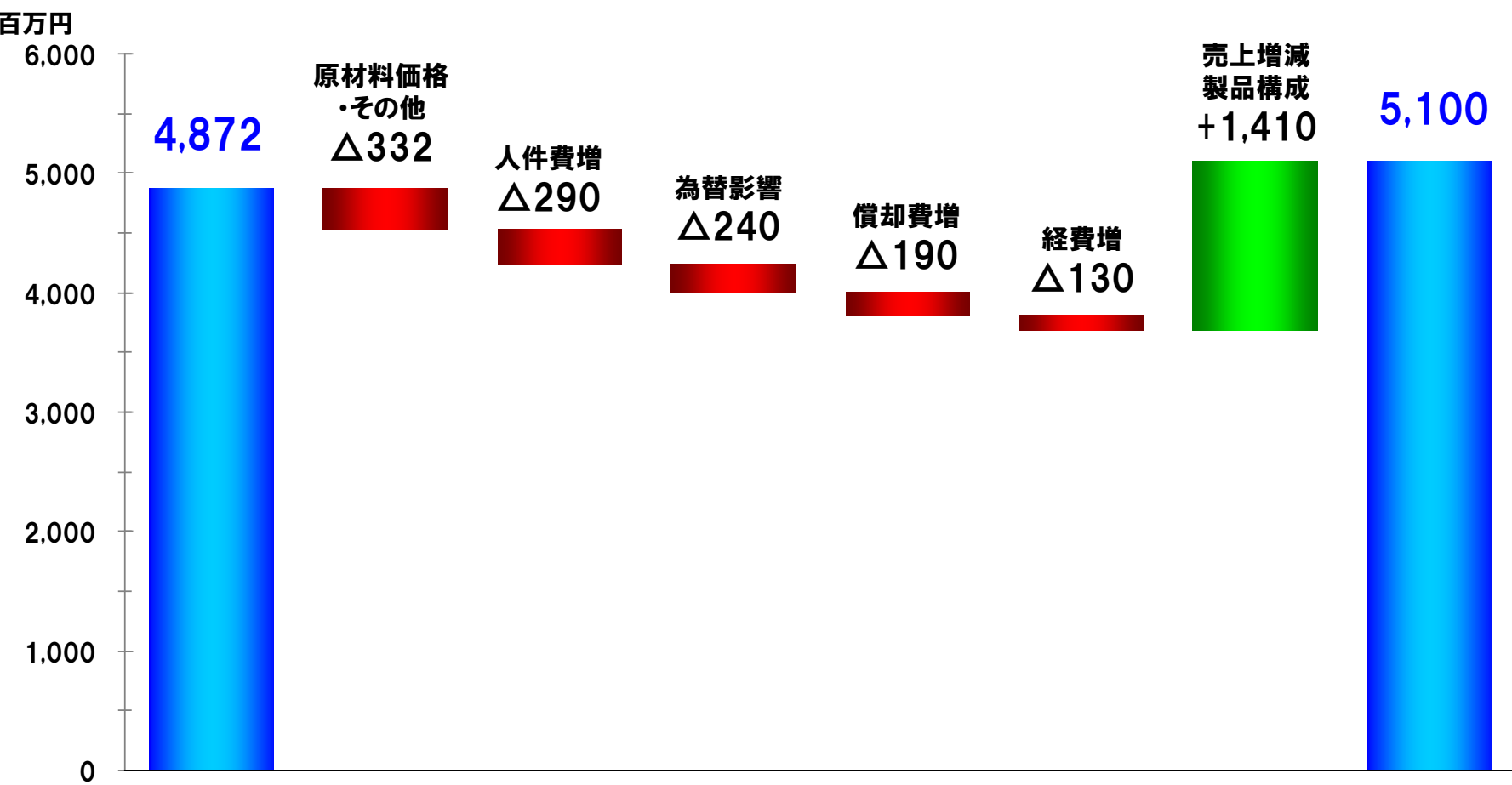
営業利益増減要因

17/3期実績→18/3期実績



営業利益増減要因

18/3期実績→19/3期予想



5. 株主還元

■ 利益配分に関する基本方針

ポイント1 目標は連結配当性向 50%以上

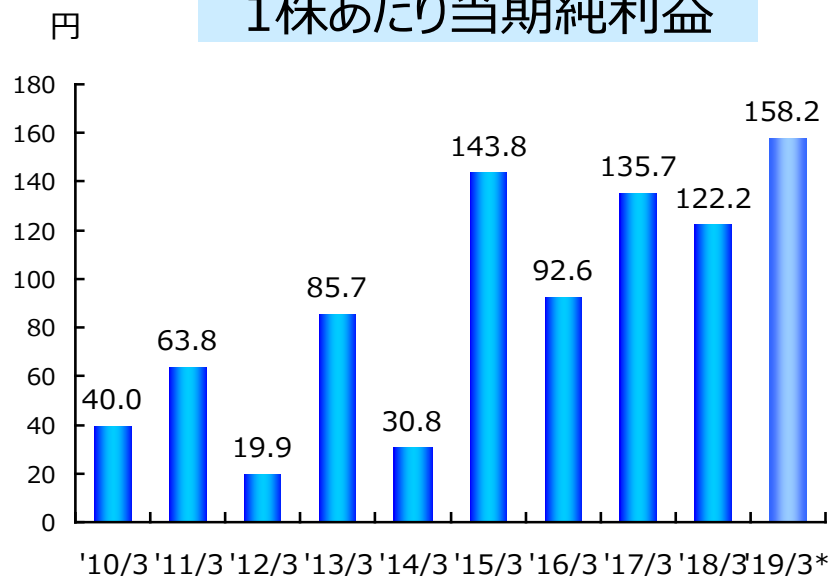
ポイント2 安定配当の継続

■ 1株あたり配当

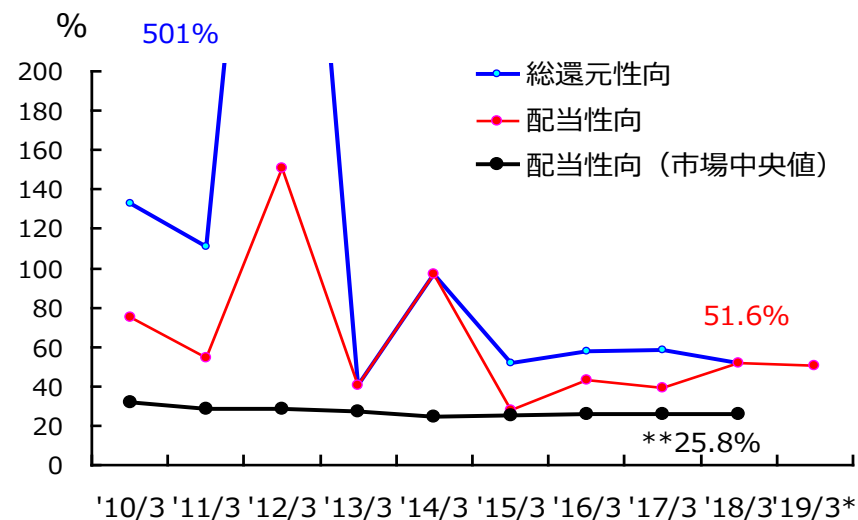
	2018/3月期	2019/3月期
中間配当金	25円 (実績)	40円 (予定)
期末配当金	38円 (予定)	40円 (予定)
年間配当金	63円 (予定)	80円 (予定)

安定配当と自己株買いによる積極的な株主還元

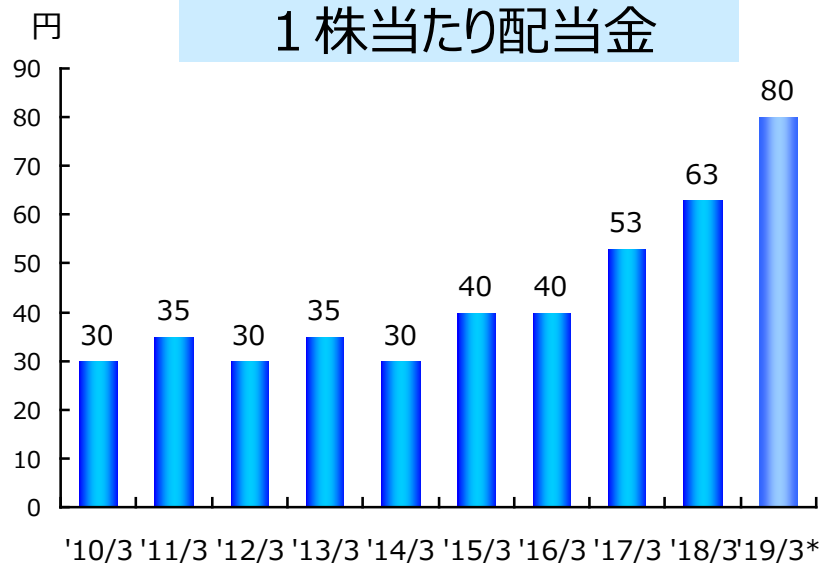
1株あたり当期純利益



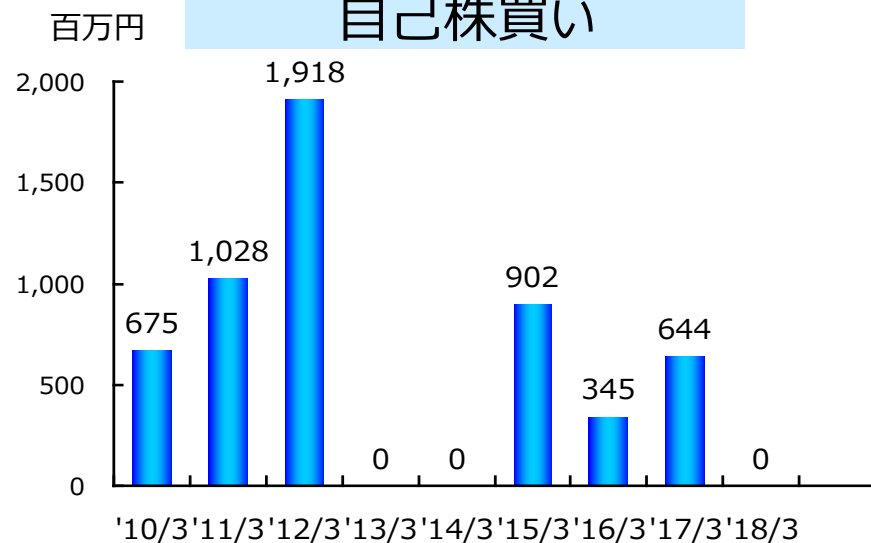
総還元性向・配当性向



1株当たり配当金



自己株買い

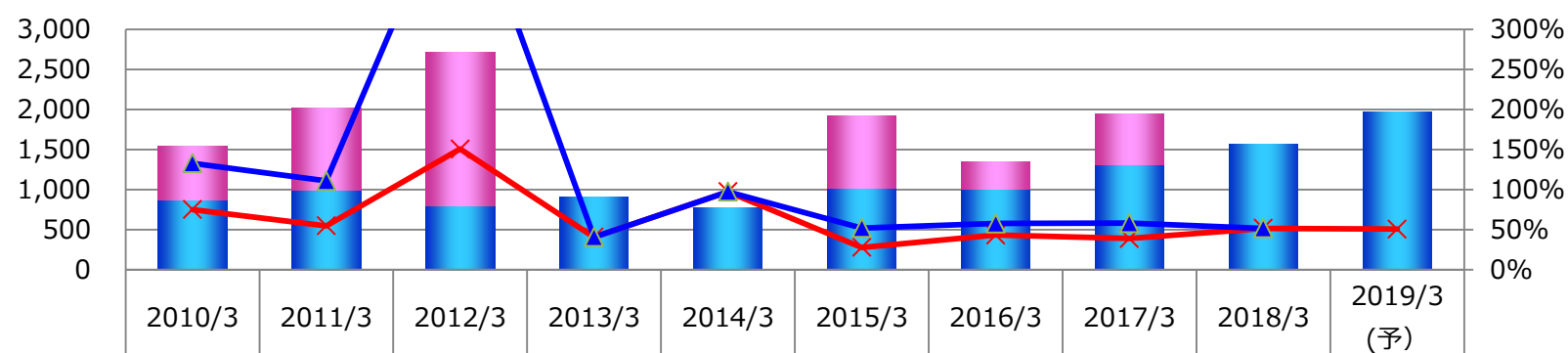


* 19/3は予想

** SMBC日興証券予想

安定配当と自己株買いによる積極的な株主還元

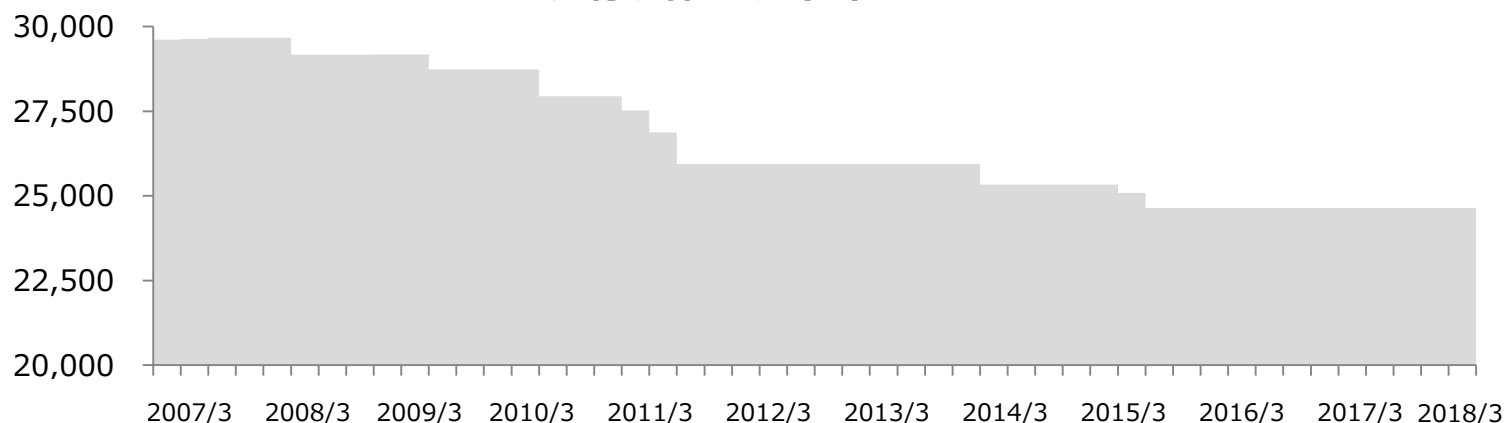
配当総額と配当性向



自己株式取得	675	1,028	1,918	0	0	902	345	644	0	
現金配当	868	989	801	907	778	1,022	1,008	1,306	1,567	1,971
配当性向	75.0%	54.8%	150.7%	40.8%	97.3%	27.8%	43.2%	39.0%	51.6%	50.6%*1
総還元性向	132.9%	110.8%	500.8%	40.8%	97.3%	52.1%	57.7%	58.2%	51.6%	
1株当たり配当金 (円)	30	35	30	35	30	40	40	53	63	80

*1: 予想

発行済株式数 (※)



※ 自己株式は除く

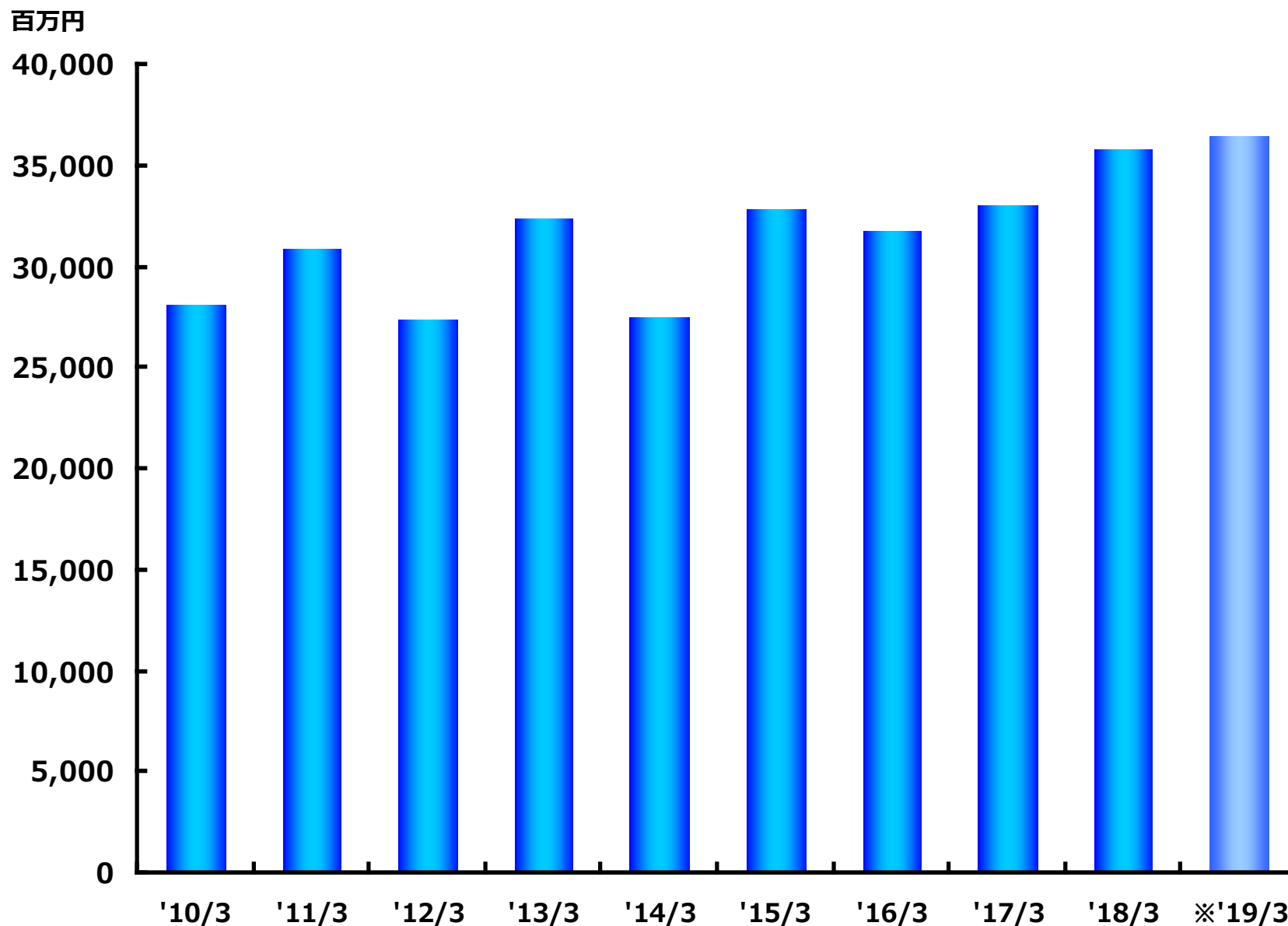
補足データ資料

グループ人員 内訳

(人数)	17年3月期 (3月31日現在)		18年3月期 (3月31日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 ※	正社員	臨時 雇用者 ※	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	568	155	580	173	+12	+18
フジミコーポレーション	102	0	111	3	+9	+3
フジミ台湾	80	2	73	0	△7	△2
フジミマイクロテクノロジー	64	8	65	8	+1	—
フジミヨーロッパ	4	1	4	2	—	+1
フジミ韓国	3	1	5	0	+2	—
フジミ深圳	6	0	6	0	—	—
合 計	827	167	844	187	+17	+20

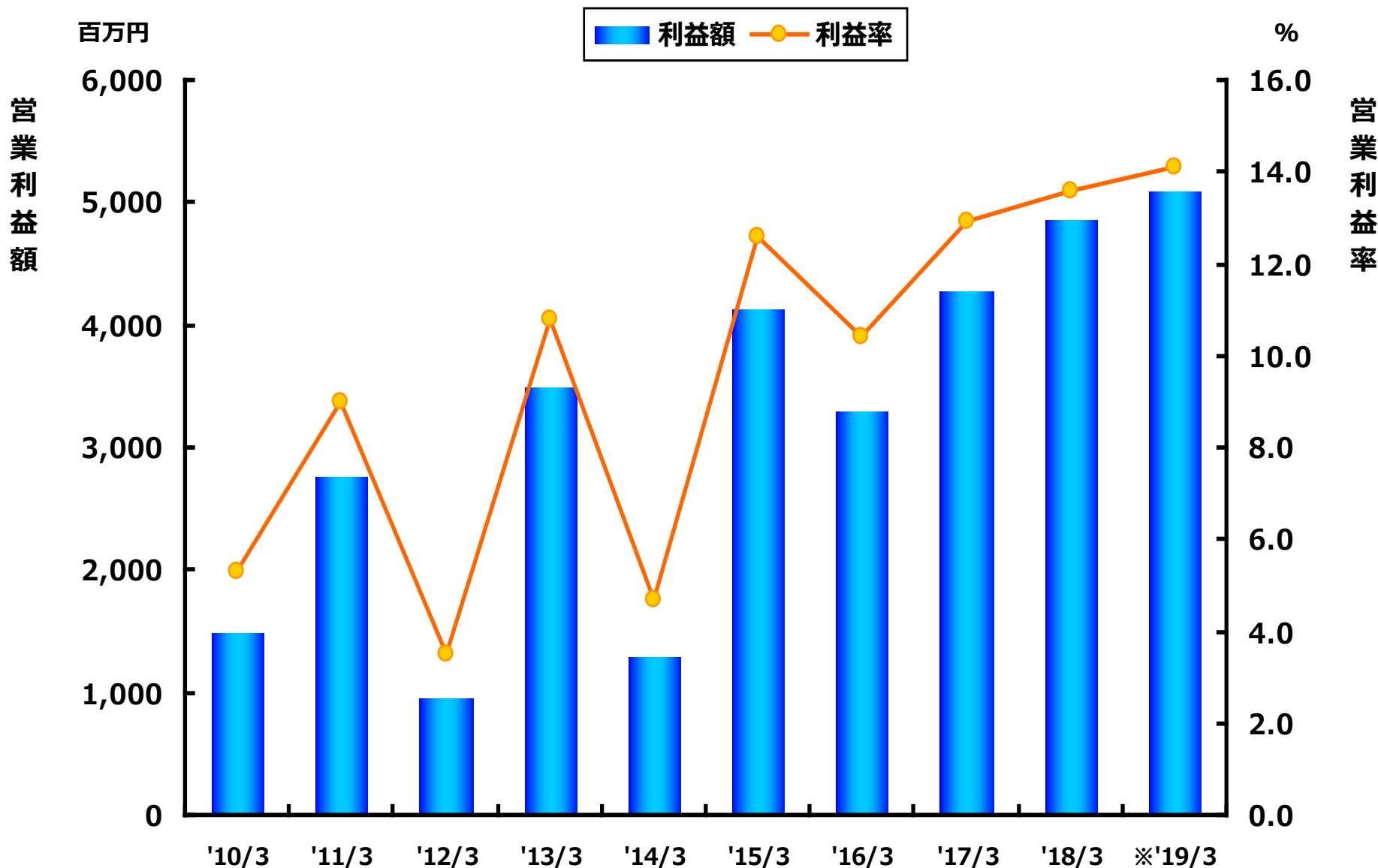
※ 臨時雇用者（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員

売上高 (通期)



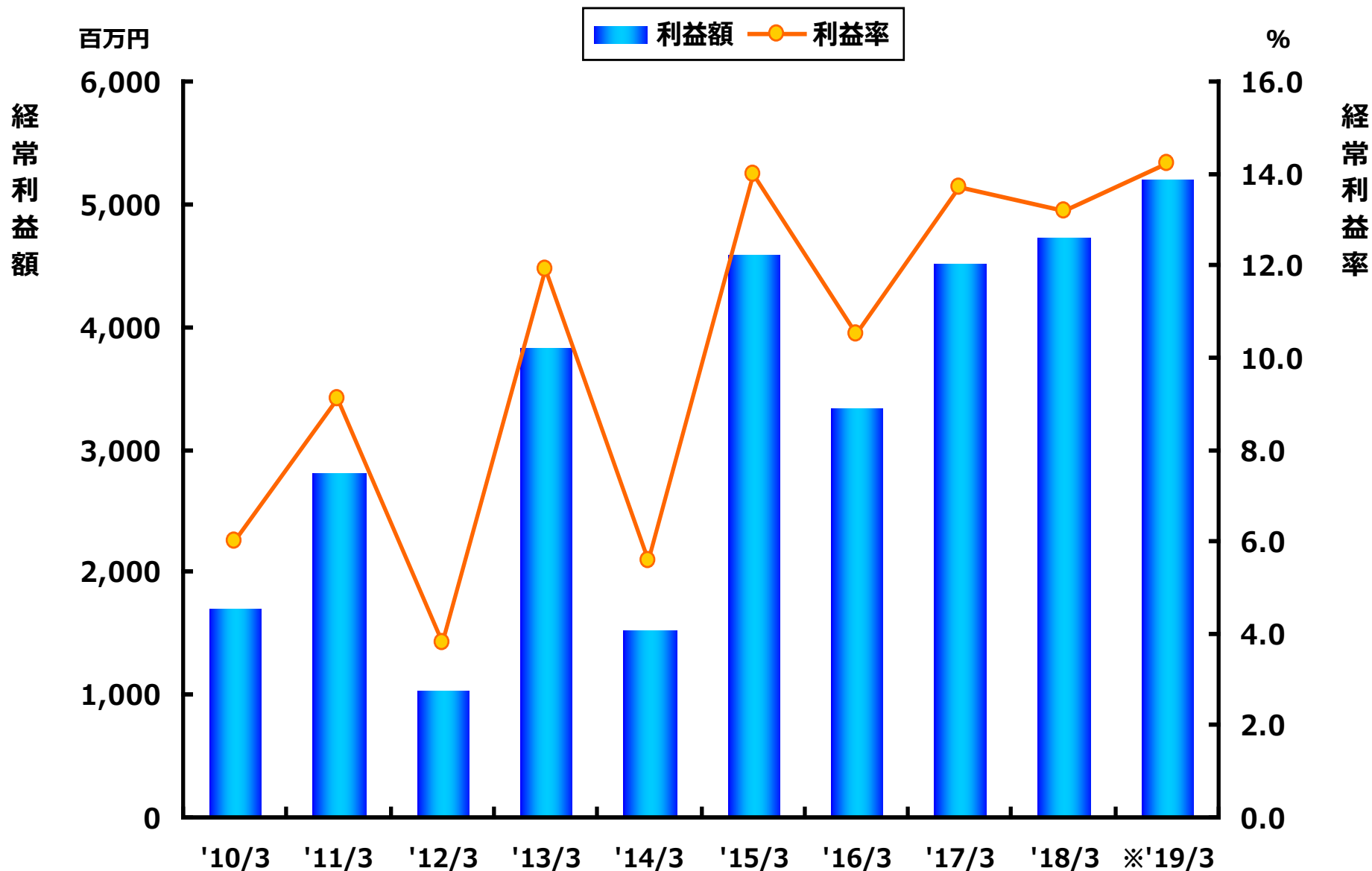
※'19/3は“5月発表”業績予想数値

営業利益 (通期)



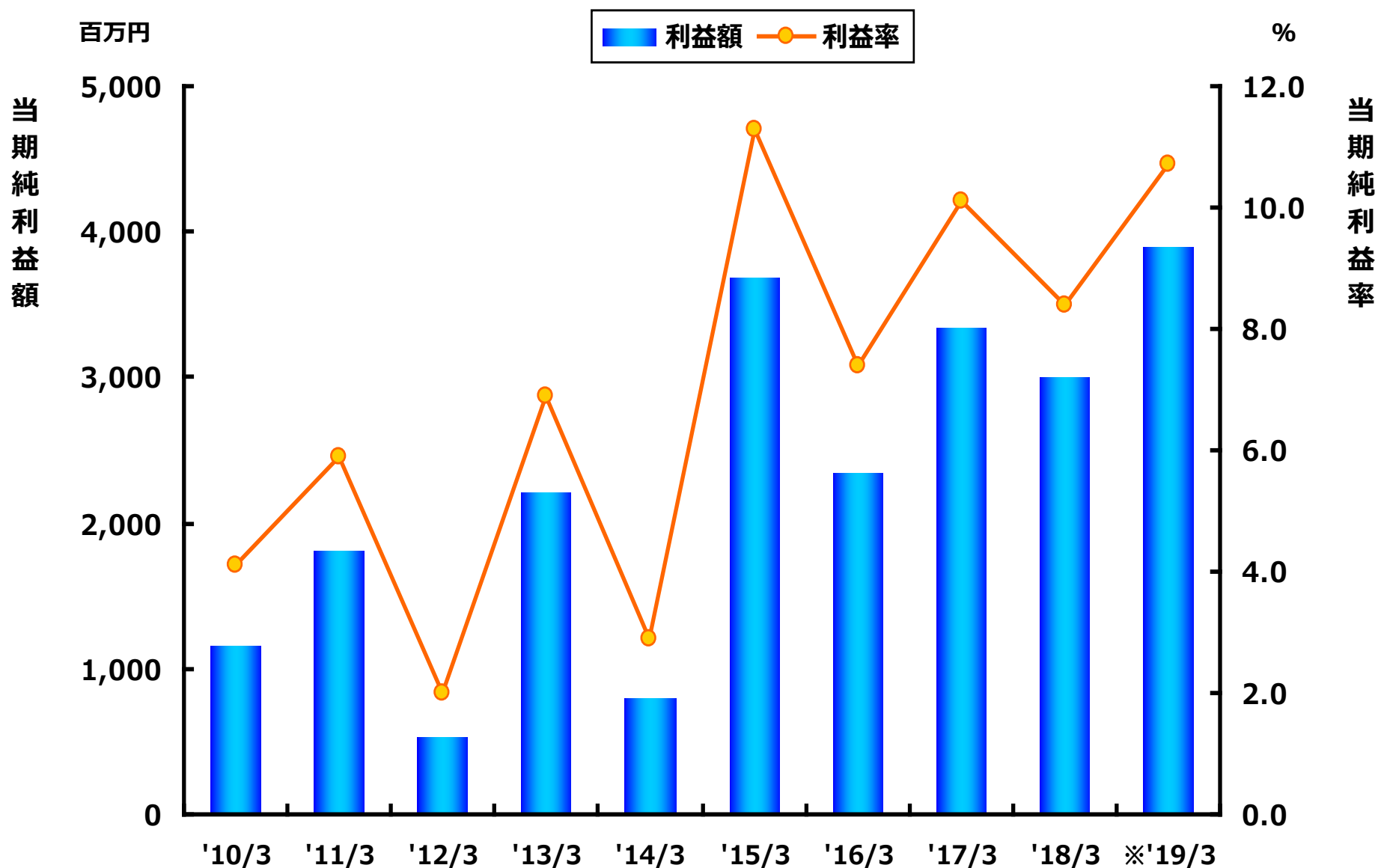
※'19/3は“5月発表”業績予想数値

経常利益 (通期)



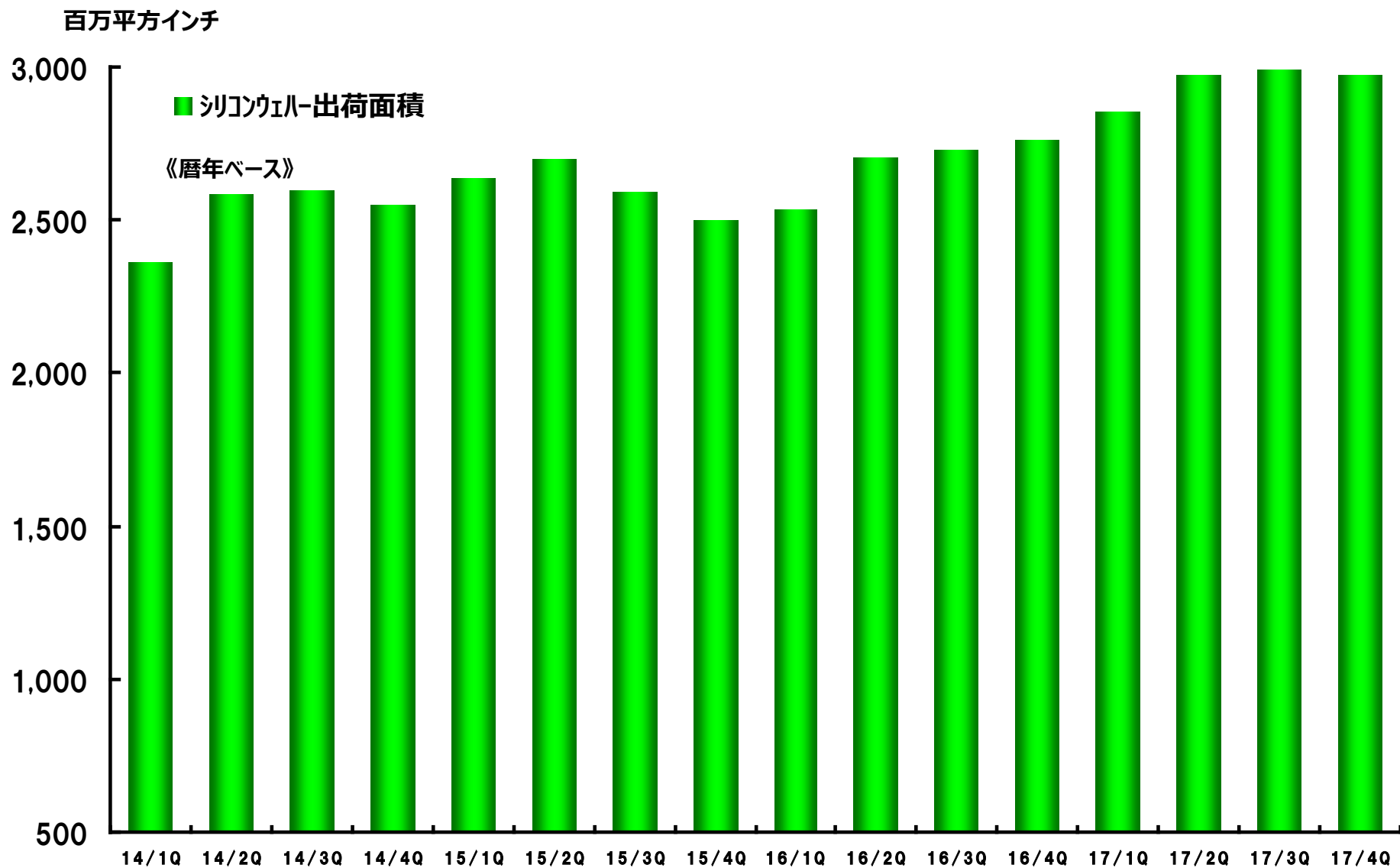
※'19/3は“5月発表”業績予想数値

当期純利益 (通期)



※'19/3は“5月発表”業績予想数値

シリコンウェハー出荷面積 (四半期)

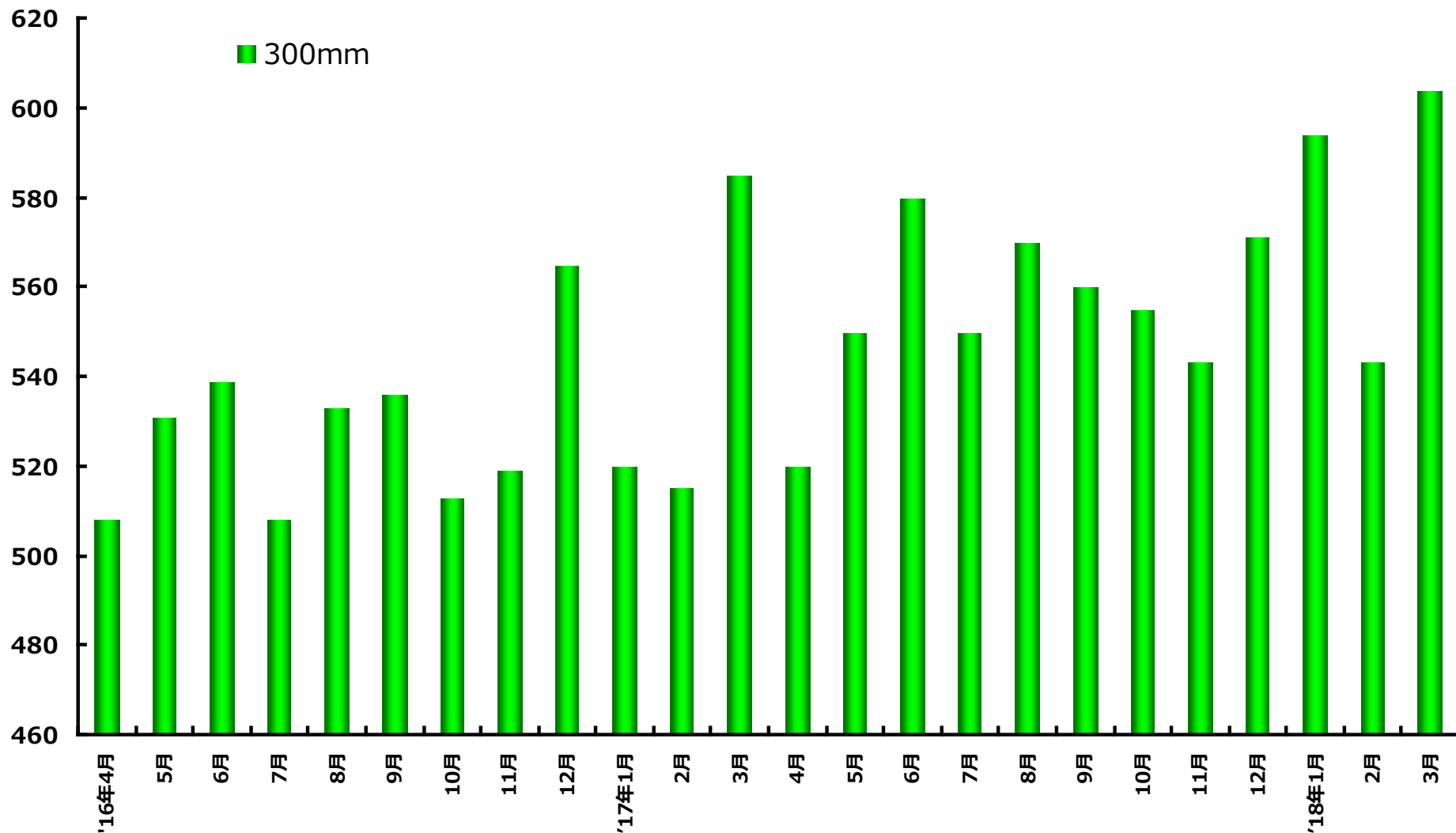


出所: SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

300mmシリコンウェハー出荷枚数（月次）

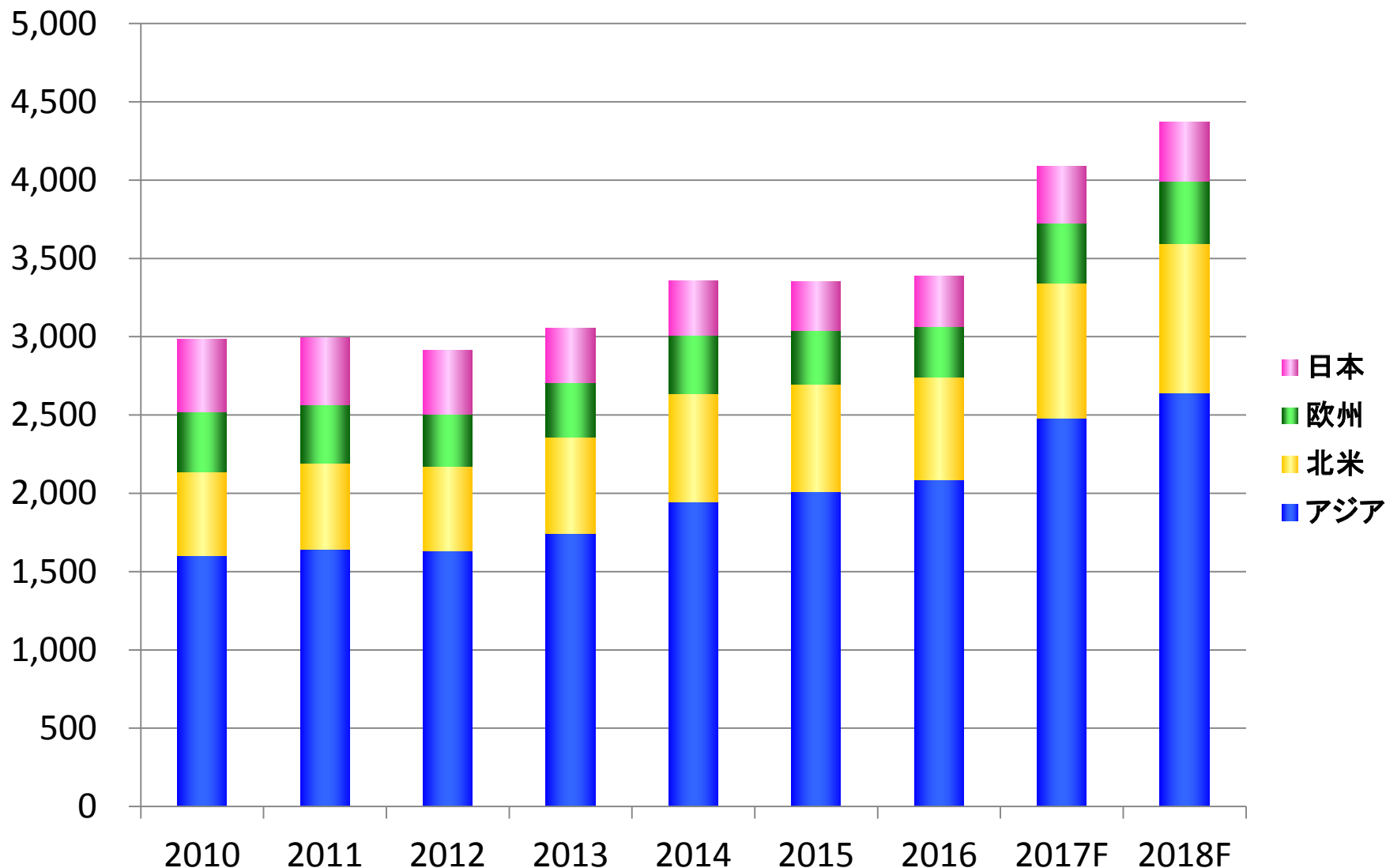
出所： 自社推定

万枚



半導体市場規模 (地域別)

(単位：億ドル)



出所：世界半導体市場統計 (WSTS) 2017秋季半導体市場予測

Q & A

ご清聴ありがとうございました